

國立金門大學 電子工程學系學士班 課程規劃表

110 學年度入學新生適用

本學系學生畢業時至少應修滿 132 學分，包括			修訂歷程		
共同必修 8 學分		通識課程 16 學分			
院必修 3 學分		系必修 61 學分			
專業選修 44 學分(包括 12 學分可選修非本學系所開設之課程)					

	一年級		二年級		三年級		四年級		四年級		四年合計	
	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數		
共同必修	通識											16
	體育											0
	國文(一)	2	2									8
	英文(一)	2	2									
	服務教育	0	1									
	國文(二)			2	2							
	英文(二)			2	2							
服務教育			0	1								
共同必修總計											24	
院必修	微積分											3
	院必修總計											3
專業必修	普通物理實驗(一)											1
	普通物理學(一)											3
	數位邏輯											3
	材料科學與工程導論(一)											3
	計算機概論											3
	微積分(二)											3
	普通物理學(二)											3
	普通物理實驗(二)											1
	程式設計											3
系必修總計											13	
專業必修總計											16	
共同選修	科技新聞導讀											2
	科技新聞翻譯											2
	線性代數											3
	專題研究(一)											2
	工程倫理											3
	校外專業實習(一)											4
	專題研究(二)											2
	企業實務培訓											3
	校外專業實習(二)											4
	通訊與系統應用領域	數位邏輯實習										
數位系統設計											3	
機率與應用											3	
工程模擬軟體											3	
物件導向程式設計											3	
資料結構											3	
計算機結構											3	
機器人控制入門											3	
數值分析											3	
嵌入式系統概論											3	
固態與積體電路領域	材料科學與工程導論(二)											3
	微處理器系統與實驗											3
	單晶片原理應用											3
	固態分析技術											3
	硬體描述語言程式設計與模擬											3
	電腦輔助電路設計											3
	表面工程											3
	前置性類比積體電路佈局設計											3
	感測器實務											3
	再生能源薄膜工程											3
能量轉換原理											3	
射頻積體電路與模擬											3	
超大型積體電路設計											3	
模式化通訊IC設計											3	
半導體元件及物理											3	
太陽能技術											3	
高頻電路佈局與模擬											3	
類比積體電路設計與模擬											3	
半導體製程技術											3	
專業選修總計											0	
學期總計											16	

備註：

- 一、畢業總學分132學分，共同必修 24學分[含通識課程16學分（由通識中心規劃）]，專業必修（含院必修及系必修）64學分，選修學分包含12學分可選修非本系所開設之課程，且須通過「本校學生英文及資訊能力畢業門檻及輔導辦法」相關規定始可畢業。
- 二、已修習通訊原理方可選修數位通訊導論、數位通訊系統、通訊實驗。已修習信號與系統方可選修數位信號處理概論。已修習微積分(一)方可修習微積分(二)。
- 三、院必修微積分即為本系必修微積分(一)。
- 四、「專題製作(一)、(二)、(三)」得抵修「專業實習(一)、(二)、(三)」。
- 五、碩班任一學期「專題討論」得抵修任一學期「專題製作」。
- 六、學士班四年級課程與碩士班課程名稱相同時，課程同時適用碩士班。
- 七、表列選修科目為預定科目，將視實際需要而調整。